



部品内蔵技術委員会主催 2023年度第三回公開研究会

主催：EPADs技術調査委員会

◆公開研究会のご案内

部品内蔵技術委員会のEPADs技術調査研究会より2023年度第三回目となる公開研究会を開催します。

今回のテーマは、「部品内蔵技術と多機能化を支える次世代実装技術」となります。

実装材料や配線技術について、幅広くご紹介いただきます。

開催日時 2023年12月19日火曜日 13:10～17:10

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:10～13:15 オープニング 司会 EPADs技術調査研究会 主査 藤村 迅

13:15～14:00 「テーマ 機能集積配線板技術動向」
FICT株式会社 吉村 英明 氏



<概要>

JPCA発行2023年度版プリント配線板技術ロードマップの第6章に掲載されている、部品内蔵基板技術の発展技術としての機能集積配線板技術の概要と、AI、データセンター向けのサブストレート技術として開発が進む、チップレット、ガラスサブストレートへの同技術の注目性を解説する。

14:00～14:45 「テーマ チップレット集積化ポストサスペンディッドブリッジ(PBS)構造の狭ピッチCuピラー接続技術について」
アオイ電子株式会社 河野 一郎 氏



<概要>

ICチップ間のデータ転送帯域を維持したまま、製造プロセス、構造、機能の異なるICを多数集積したチップレット集積技術は、フォン・ノイマンボトルネックなどの問題を解決する手法として注目されている。
本発表ではポストサスペンディッドブリッジPSB構造における狭ピッチCuピラーの接合検証結果について述べる。

14:45～14:55 休憩

14:55～15:40 「テーマ 大気雰囲気・無加圧スナップ焼結ナノ銅インクによる環境にやさしい配線技術」
タツタ電線株式会社 坂口 充弘 氏



<概要>

環境に優しい基板配線技術・工法として、エッチング処理やめっき処理に置き換わるプリンテッドエレクトロニクスは、10年以上前からAgインク・ペースト印刷を中心に提案されて来っていたが、高コストやマイグレーションなどが課題であった。
本講演では、過去の課題を解決可能するために新開発した「大気雰囲気・無加圧スナップ焼結が可能なナノ銅インク印刷技術」について紹介する。

15:40~16:25 「テーマ パナソニック インダストリー 宇宙曝露にも耐えうる電子材料のご紹介」
パナソニックインダストリー株式会社 出口 隆啓 氏



<概要>

弊社では電子回路基板材料と実装補強材料の宇宙曝露実験を通じて、宇宙環境下での材料の耐久性や信頼性の評価を進めている。

本講演では、国際宇宙ステーションで曝露実験を行ったMEGTRON、XPEDION、LEXCMなどの紹介を行う。

16:25~17:10 「テーマ シリコンキャパシタの最新動向」
株式会社村田製作所 松岡 高広 氏



<概要>

現在、キャパシタに対し、高信頼性、高周波対応、小型薄型などが求められており、日々強まるそれらの要求に対して応えるためのソリューションがシリコンキャパシタである。

シリコンキャパシタは、そのカスタム性の高さから様々な実装形態に対応可能な特長がある。本講演では、基板埋め込みを含めたシリコンキャパシタの実装について述べる。

参加要項

定員 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円 非会員学生:2,000円 協賛団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
 - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
 - ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
 - ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- *キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員/賛助/非会員の方

※クーポン利用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info@jiep.or.jp
(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)